

M1FE40

400V 2A

特長

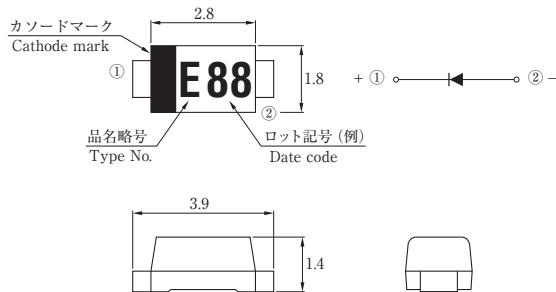
- ・小型 SMD
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・静電気耐性に優れている

Feature

- Small SMD
- High-Reliability
- High ESD Capability

■外観図 OUTLINE

Package : M1F

Unit : mm
Weight : 0.027g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

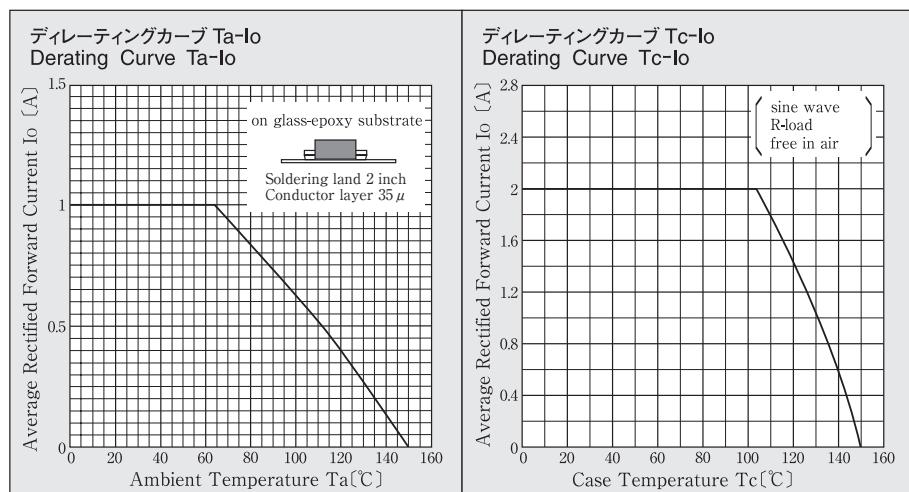
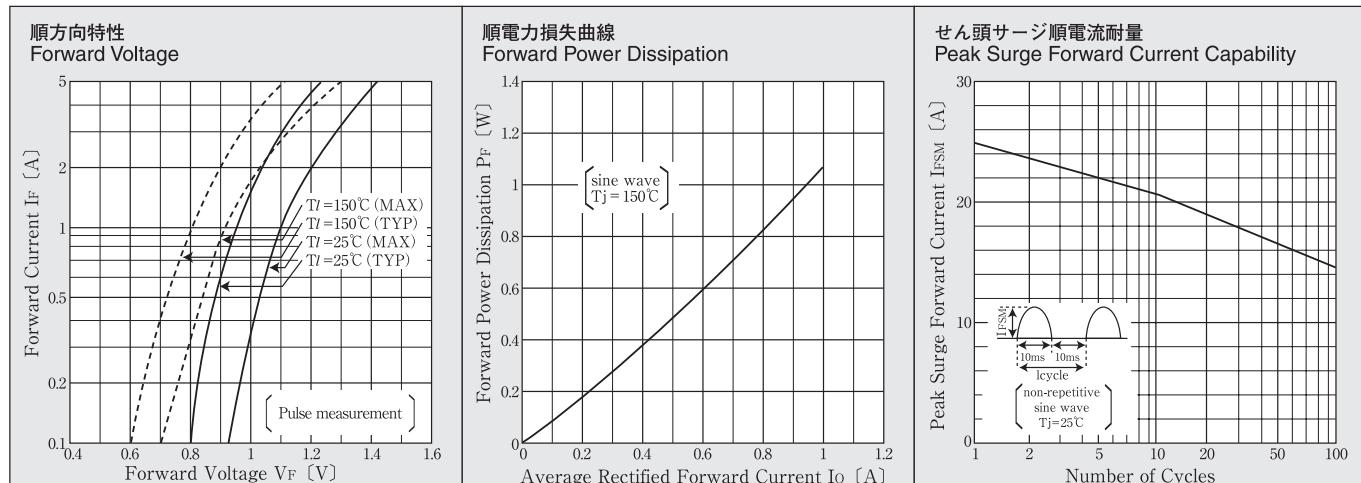
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M1FE40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Tc=103°C プリント基板実装, Ta=63°C On glass-epoxy substrate	2.0 1.0	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25°C		25	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjL	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 20	°C/W
	θja	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 80	
	θjc	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 18	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.